

# 26년 AI·스마트전자제품 개발·제조 지원 모집

## □ 모집개요

- **(지원목적)** 스타트업 및 중소기업 우수제품의 개발, 제조에 이르는 과정을 공동개발 형태로 지원
  - \* AI·스마트전자제품 : AI 및 IoT·센서·통신·액추에이터 제어기술을 적용한 중·소형 전자제품
- **(지원대상)** 전자기기 기반 제품을 개발, 제조하는 스타트업 및 중소기업
- **(지원내용)** 회로설계, 기구설계, 시제품제작(전자보드, 목업), 펌웨어, 금형에 이르는 과정에서 발생하는 애로사항에 대한 기업 지원

## □ 지원사항

- **(지원기간)** 지원 시작일로부터 10개월 이내 ('26.3월 ~ '26.12월 예정)
- **(지원방법)** 지원 분야에 따라 서울용산시제품제작소 전자제조센터 내 엔지니어, 장비로 직접 지원하며, 개발 과정에서의 산출물(도면 등)은 기업에 귀속
- **(세부내용)** 본 사업은 수행기관과 선정기업이 공동개발 방식으로 추진되며, 지원 범위를 초과한 추가 시제품 제작 요청 시 재료비(실비)는 선정기업 부담

구분	지원분야	지원항목	지원내용	비고
유형1	하드웨어 (전자보드)	전자회로개발	- 전자회로 설계, 아트웍, 부품선정 - 전자보드(PCB) 제작, 조립, 검사	- 유형1 지원 항목 내 중복 선택 가능  - 유형1, 유형2 각각 별도의 신청서 작성
		펌웨어개발	- 펌웨어 설계, 디버깅	
		전자보드 제작	- 표면실장(SMT), 조립, 검사, 측정	
	기구 (하우징)	3D모델링	- 외형 컨셉 단계의 3D모델링 / 디자인 - 3D랜더링 디자인 이미지 지원	
		기구설계	- 조립, 공정, 금형, 양산성 등을 고려한 시제품 제작 전 세부 설계	
		시제품제작 (3D프린팅)	- 산업용 SLA 타입(450*450*350mm 이내) - 산업용 FDM 타입(355*254*355mm 이내) - 폴리젯 타입(투명, 풀컬러 가능) * (붙임3참조)	
유형2	금형지원	금형제작	- 금형 설계(2D, 3D) - 금형 제작 지원(사출 등)	

- \* 유형1, 유형2 두 개의 지원항목 동시에 수혜 불가(두 유형에 동시에 선정될 경우 한 유형 포기)
- \* 유형1 지원 항목을 복수 선택했다라도 선정평가결과, 개발 일정, 난이도에 따라 일부만 지원할 수 있음
- \* 유형2 지원은 제품 전자보드 개발, 디자인 및 기구 설계가 완료되어 금형 제작을 앞둔 기업에 한정

○ **(지원규모)** 선정 평가를 통해 지원 제품 선정(기업 당 1개 제품)

- **(유형1) 제품개발 지원 최대 30개 제품**

- \* 전자보드 시제품 제작 수량은 최대 30개, 시제품 3D 프린팅은 최대 10개까지 제작 지원하며, 선정 후 협의에 따라 변동 가능
- \* 난이도, 제품 크기, 지원요청 내용에 따라 수량 조절 또는 일부 기업분담금이 있을 수 있음(협의 사항)
- \* 3D모델링, 기구설계 지원의 경우 기업에서 컨셉 및 스케치 또는 도면을 제공해야 함

- **(유형2) 금형지원 최대 8개 제품 (기업당 최대 1,500만원 상당 제작 지원)**

- \* 금형에 대한 원가 분석 후 예산 범위 내에서 지원하며, 초과 금액은 선정기업 부담
- \* 금형지원 신청 시 3D모델링, 기구도면 자료 제출(진행 상황 검토용)

- 선정기업에 **사업비 지급이 아닌** 서울용산시제품제작소 인프라를 활용한 직접 및 간접 지원이며 선정 평가 결과, 제품 크기, 부품 수에 따라 지원예산 조정

- \* 제작 완료 후 서울용산시제품제작소에서 전문공급업체에 지원금 직접 지급

□ **신청 및 문의**

○ **(신청기간)** '26. 1. 30(금) ~ 2. 19(목), 18:00까지

○ **(신청 및 접수)** 스타트업플러스 플랫폼 내 접수 <https://yfactory.startup-plus.kr/>

\* 회원가입 후 로그인 → 마이페이지 → 상단 'Apply\_지원사업신청' 클릭 → 목록에서 26년 'AI-스마트전자제품 개발·제조 지원 모집' 공고 클릭 → 첨부된 신청서 양식 다운로드 후 작성 → 신청서 작성 클릭 → 신청서 작성 및 해당 서류 등 첨부파일 업로드 → 신청완료

\* 신청서 파일용량 초과하여 업로드 안 될 경우 이메일(yes@gokea.org)로 제출

○ **(문의)** 서울용산시제품제작소(운영기관 : 한국전자정보통신산업진흥회)

\*이메일 : [yes@gokea.org](mailto:yes@gokea.org)

\* 원활한 확인 및 정확한 답변을 위해 이메일 문의를 우선 접수 후 순차 회신

제출 서류	비고
① 신청 및 계획서 (유형1, 유형2)	붙임 1
② 개인(기업)정보 수집·이용·제공 동의서	붙임 2
③ 사업자등록증	-
④ 제품자료 * 해당시 제출 : 카탈로그, 2D/3D도면, 이미지 등 * 기존 하드웨어 개발 관련 데이터 보유 시 회로도, 부품리스트 등 제출 * 모델링 관련 데이터 제출 시 확장자(STP, STEP) 확인하여 제출	-

## □ 평가 및 선정

- (평가절차) 총 2단계 평가 (서류 → 발표)를 통해 최종 선정

\* 평가 결과 및 일정은 이메일 및 문자로 안내

- (평가방법)

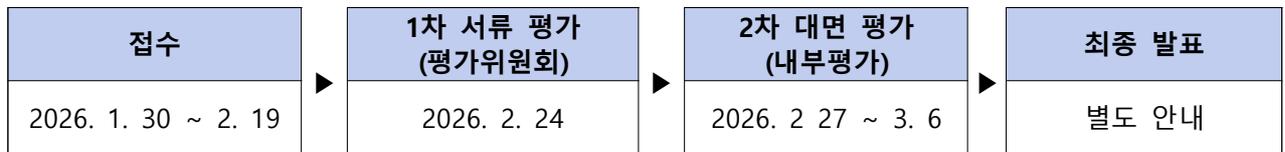
- 1차 서류평가는 평가위원회를 통해 구비서류 세부 항목 평가 및 발표평가 대상자 확정

\* 1차평가 : 외부전문가로 구성, 질문 발생 시 통화에 의한 질의, 응답 예정

- 2차 발표평가는 제출 서류 기반으로 대면 또는 온라인(Zoom)으로 진행 예정

\* 평가시간 : 20분 이내 (발표 10분 이내 + 질의응답)

### < 지원기업 선정평가 절차 >



\* 평가기준에 따라 60점 이상 중, 고득점 순으로 '최종대상자' 선정

\* 결과는 선정기업에 한하여 개별 통보되며 우선순위에 따라 지원 일정 별도 협의

\* 일정은 내부 사정에 따라 변동될 수 있음

## □ 선정기준

- (1차 서류 평가)

평가기준	배점	상세평가항목(점)
필요성	30	- 달성하고자 하는 목표의 명확성(15) - 신청제품의 사양, 현재 상황 등 지원의 필요성(15)
혁신성	30	- 독창성 및 참신성(15) - 기술경쟁력 및 기술적 우수성(15)
타당성	40	- 지원내용, 범위, 일정의 구체성(10) - 제품화(사업화) 가능성(20) - 개발 종료 후 성과 및 목표달성 방안(10)
가산점	+10	- 서울시 소재 기업 - 서울시 소재 기업부설연구소 및 연구개발전담부서 포함

\* 가산점은 접수 마감일까지 서울시 소재 기업으로 등록된 기업(서류 평가에만 적용, 증빙 제출 필수)

- (2차 대면 평가)

평가기준	배점	상세평가항목(점)
개발 가능성	30	- 제품 개발 경험(10) - 연구 개발 인력 현황(10) - 지원기업의 기술역량과 노하우(10)
지원 필요성	20	- 개발 진행 단계(10) - 지원 프로그램 활용 범위(10)
개발 난이도	30	- 기술 우수성(10) - 기간 내 개발 가능성(20)
사업 참여 의지	20	- 참여 의지(10) - 대응 신속성(10)

## □ 신청 시 유의사항

- 제출서류가 미비할 경우, 요청 기한 내 미제출 시 신청 포기로 간주
- 동일 개발 내용으로 정부지원(지자체 포함) 받은 경우 중복지원 제외
- 채무불이행, 국세·납세 체납된 자 또는 기업의 경우 신청 제외
- 제출된 세부사업계획서 등의 허위, 위·변조, 그 밖에 부정하게 작성된 경우 선정 취소 및 협약 해약
- 선정 기업이 과실로 인해 지원 기간 내에 사업 수행이 불가능할 경우 선정 취소 및 조기 종료
- 정당한 사유 없이 지원 기간 중 관련 서류 미제출의 경우 선정 취소
- 사업의 목적과 맞지 않거나, 지원 범위 밖의 요청은 수용할 수 없으며, 지속 요청할 경우 선정 취소 또는 조기 종료
- 제출된 서류는 일절 반환 불가
- 심사결과(점수, 순위, 평가위원 의견 및 세부 평가내역)는 비공개를 원칙
- 개별 기업의 선정·미선정 사유에 대한 별도 피드백 제공은 불가
- 선정기업에 한해 3년간 사업성과(고용, 매출) 확인을 위하여 4대보험 사업장 가입자 명부, 사업화 매출액 확인서 등 성과 관련 서류 제출 의무
- 잘못된 담당자, 전화번호, 이메일 등을 기재하여 발생한 평가 안내, 결과 통보 등 미수신(연락 불능)의 책임은 신청기업에 있음

## □ 선정 후 유의사항

- 사업비 지원이 아닌 서울용산시제품제작소 KEA 전자제조센터 인프라를 활용한 직접 및 간접 지원이며 제품 크기, 부품 수에 따라 차등 지원(협의 사항)
- 신청계획서상의 지원희망 시기에 따라 상반기, 하반기 지원으로 분류되며, 협의에 따라 지원 일정은 변경될 수 있음
- 제품개발지원 항목을 복수 선택했다라도 개발 일정, 난이도에 따라 협의 후 변경될 수 있음
- 금형 제작 지원은 디자인, 기구설계가 완료되어 제품의 PILOT 생산 및 사업화 준비가 진행된 기업에 한정
- 제출된 서류 및 세부사업계획서 등의 허위, 위·변조, 그 밖에 부정하게 작성된 경우 선정 취소 및 협약 해약 진행

붙임 1. (양식: 유형1,2) AI·스마트융합전자제품 개발·제조 지원 신청 및 계획서

붙임 2. 개인(기업)정보 수집·이용·제공 동의서

붙임 3. 제품화 지원 장비 사양 요약